



2024年12月16日

各 位

会社名 品川リファクトリーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤原 弘之  
(コード番号 5351 東証プライム 札証)  
問合せ先 IR・広報部長 矢野 孝佳  
(TEL 03-6265-1614)

## 先端機材セクターの成長戦略について

当社の100%子会社である品川ファインセラミックス株式会社(以下「品川FC」)は、生産基盤の整備と生産能力の拡大に向けた設備投資を実施することを決定し、当社は2024年11月7日開催の取締役会においてこの実施を承認いたしました。

この度、新工場建設のための事業用地に関する定期借地契約の締結が完了いたしましたので、下記の通りお知らせします。(補足資料もご参照願います。)

### 記

#### 1. 投資の目的

品川FCは、半導体製造装置をはじめとした先端産業分野への事業拡大を目標とする「先端機材セクター」の中核企業であり、国内におけるファインセラミックス製品の製造販売を担っています。

今回の投資は、現行の第6次中期経営計画(2024~2026年度)の3か年で30億円を投じ、「製品生産能力の強化」、「製品品質の向上」、「生産コストの低減」など様々な効果が見込めるものとなります。

先端機材セクターでは、品川FCにおいて半導体製造装置向けにファインセラミックス製品を製造販売しておりますが、昨年度より新たに加わったコムイノベーション社との協働により、同市場の拡大する需要を幅広く捕捉する為の製品開発を強化しております。今後は、進化する半導体および半導体製造装置における技術動向も十分に把握し、さらに今回の設備投資による生産能力の拡大効果を最大限に発揮して、設計・アSEMBリ・検査事業を含めた半導体製造装置関連市場へのさらなる浸透を図ります。

#### 2. 新成長分野の捕捉

第6次中期経営計画期間においては、半導体製造装置関連市場における成長を目指しておりますが、次期となる第7次中期経営計画(2027~2030年度)においては、今回の投資により整備された生産基盤をベースにさらなる成長投資を行うことによって、当社グループが新成長分野と位置付けている「航空宇宙・エネルギー関連」などへの本格参入を目指します。

具体的な例としては「航空機部材用 特殊蒸着材」、「リチウムイオン電池などの電池製造関連製品」等であり、この分野での需要の捕捉に向けて既に当社の技術研究所で製品開発を進めており、併せて、各方面から、開発に資する情報収集も行っております。

これらの成長戦略により、2030年度の「先端機材セクター」の売上高は、2023年度の35億円から、2.6倍の90億円に伸ばすことを計画しております。

以 上

# 先端機材セクターの成長戦略について (補足資料)

# 1. 先端機材セクターの成り立ち

2023年4月～（第5次中期経営計画の最終年度に実施）

●「グループ経営体制の改革」

⇒ 事業ドメインを4つのセクターに分け、各事業における専門性の追求とグループ全体の事業運営の強化が図れる経営体制へ

▶ 「セラミックスセクター」始動

- 品川ファインセラミックス社
- 海外関係会社（米国SSCA社）

2024年3月

●M&Aにより「コムイノベーション社」が当社グループに加わる

同社が担うアセンブリ・検査プロセスは、高度な技術と厳格な品質管理が求められる半体製造装置における重要な領域

2024年4月～（第6次中期経営計画の初年度に実施）

●新たな事業を加え、さらなる事業拡大に向けて「セラミックスセクター」を改組

▶ 「先端機材セクター」始動

- 品川ファインセラミックス社
- 海外関係会社（米国SSCA社）
- コムイノベーション社

## 2. 先端機材セクターにおける成長投資の概要

### 【成長に向けた課題】

(成長のために必要となる施策)

- 製品加工能力の拡充  
(外注加工処理の削減によるリードタイムの短縮)
- お客様の要求レベルの高度化に対応した製品検査能力の向上
- 設備拡充のためのスペースの確保

### 【品川ファインセラミックス社の設備投資の概要】

～生産基盤整備と生産能力拡大～

設備投資の内容	第6次中計における投資額
● 加工設備、検査装置の増設	約 <b>30</b> 億円 (第6次中計3か年総額)
● 最新鋭設備の導入による品質向上	
● 用地確保による新ライン建設	

#### 主な投資効果

生産能力の増強  
による拡販

製品加工  
コストの低減

自動化・効率化  
による  
人件費の削減

品質管理に係る  
コストの低減

今後、第6次・第7次の中計期間を通じて、先端産業分野への事業拡大を目指す

【第6次中計期間の主要ターゲット】  
半導体製造装置分野



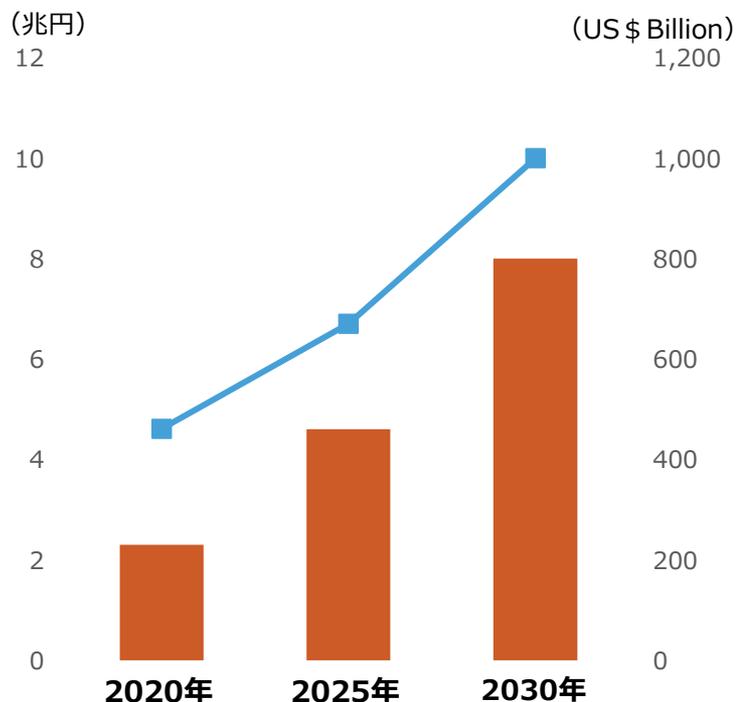
【第7次中計期間の主要ターゲット】  
新成長分野

# 3. 拡大する需要の捕捉

～半導体製造装置市場をターゲットに～

## 【半導体製造装置市場の動向】

- 世界の半導体売上高 (右軸)
- 国内製半導体製造装置売上高 (左軸)



※1 参考:SEMIジャパン

※2 国内製半導体製造装置売上高は「日本半導体製造装置販売量」から予測

## 拡大する需要(半導体製造装置市場)の捕捉に向けた課題

- 進化する半導体および半導体製造装置における技術開発動向の把握
- 新たな需要の捕捉に向けた製品開発の強化
- 生産能力の拡大と生産効率の向上  
⇒ 今回の設備投資

## 【会社別の方針】

### 品川ファインセラミックス社

コムイノベーション社との技術協力により同市場向けファインセラミックス製品の開発強化

↑ 緊密な技術協力 ↓

### コムイノベーション社

- 未進出のプロセス領域への新規参入
- 海外半導体メーカーへのサポート体制の強化

## 4. 「新成長分野」の捕捉

先端機材セクターのさらなる事業拡大に向けて…

第7次中期経営計画において  
**新成長分野(航空宇宙・エネルギー関連他)**  
への本格参入を計画

### 【新成長分野の捕捉に向けた課題】

- 新たなマーケットの捕捉に向けた技術関連情報の収集と**製品開発**の強化
- 第6次中計期間に生産基盤を整備  
⇒ 第7次中計においてもさらなる成長投資の検討

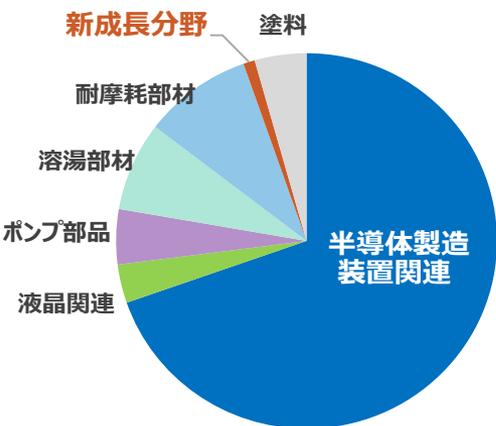
### 第6次中計期間において推進中の製品開発

- 航空機部材用特殊蒸着材
- 航空宇宙業界向け特殊耐熱セラミックス
- リチウムイオン電池等の電池製造関連部品
- 高機能金属製造用ファインセラミックノズル
- 高機能ファインセラミック塗料・接着剤  
他

# 5. 先端機材セクターの製品ポートフォリオ改革イメージ

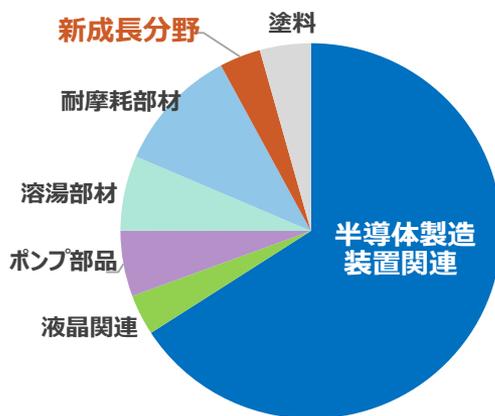
## 事業規模の拡大を図るとともに、販売構成を改善

2024年度 売上高構成比率



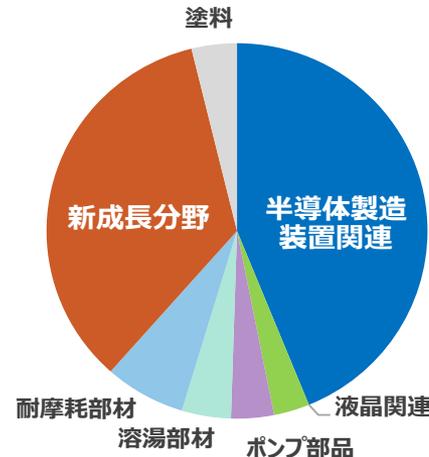
売上高 21億円

2026年度 売上高構成比率



売上高 24億円

2030年度 売上高構成比率



売上高 55億円

### 目標

（オーガニック  
成長ベース）

【品川ファインセラミックス社の売上高】

2030年度 **55**億円に拡大

【先端機材セクターの売上高】

2030年度 **90**億円へ